

レジュメ(経歴及び今後の活動内容)

| | | | | |
|--|---|---------|--------------------|------|
| 氏名 | | | | |
| 専門分類 (業務経験上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。) ※複数回答可 | | | | |
| 大分類 | 半導体パッケージ | サブストレート | プリント配線板 (リジット・フレキ) | |
| | 設計 | 製造 | 実装 | 品質管理 |
| | 経営 | 営業 | 調達 | 工場設営 |
| 小分類 | <p>設計：部品データ設計 (基板構造含む)、配線設計、CAM 出力、シミュレーション 等</p> <p>製造：資機材 (材料、薬剤、装置)、TH 加工 (穴あけ、めっき)、表面処理 (OSP、金めっき)、製造技術、生産技術 等</p> <p>実装：電子部品、搭載・接合技術 等</p> <p>品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、クレーム対策技術 等</p> <p>半導体プロセス：前工程、後工程 等</p> <p>経営：経営管理、生産管理、情報システム 等</p> <p>営業：マーケティング、技術営業 等</p> <p>調達：設備調達、材料・部品調達 等</p> <p>工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計 等</p> <p>その他 ()</p> | | | |

| 専門分類 | 専門分類において経験した業務の内容 |
|------|-------------------|
| | |

| 専門分類 | 専門分類において経験した業務の内容 |
|------|-------------------|
| | |

レジュメ作成時の注意事項

これまでの経験を活かして、企業内において、今後、どのような活動を目指しているか、A4 サイズ 1 枚以内でご記入下さい。

今後の活動内容について